

1、产品概要 / Outline

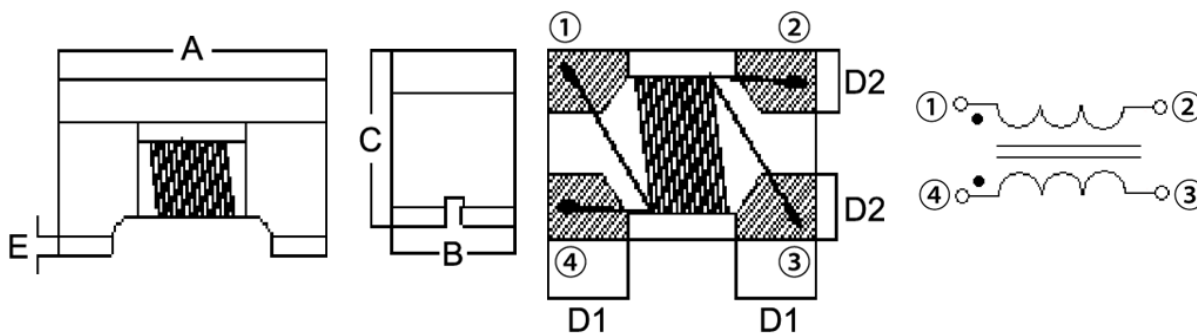
- ◆ 绕线式共模扼流器. Prevention of common mode
- ◆ 有效防止高频共模噪声
- ◆ 30Ω~2200Ω 可选用于不同的噪声水平和信号频率
- ◆ 焊接性能强
- ◆ 工作温度：-40℃~+125℃



广泛应用于各种电子产品、多媒体设备，笔记本电脑的 LVDS 线、音频线、车载动力传递的 DC 电源线的共模噪声抑制。

2、外观尺寸/ Appearance size 单位:mm

外型尺寸:



A	B	C	D1	D2	E
3.2±0.2	2.5±0.2	2.15±0.2	0.8Typ.	0.9Typ.	0.2±0.1

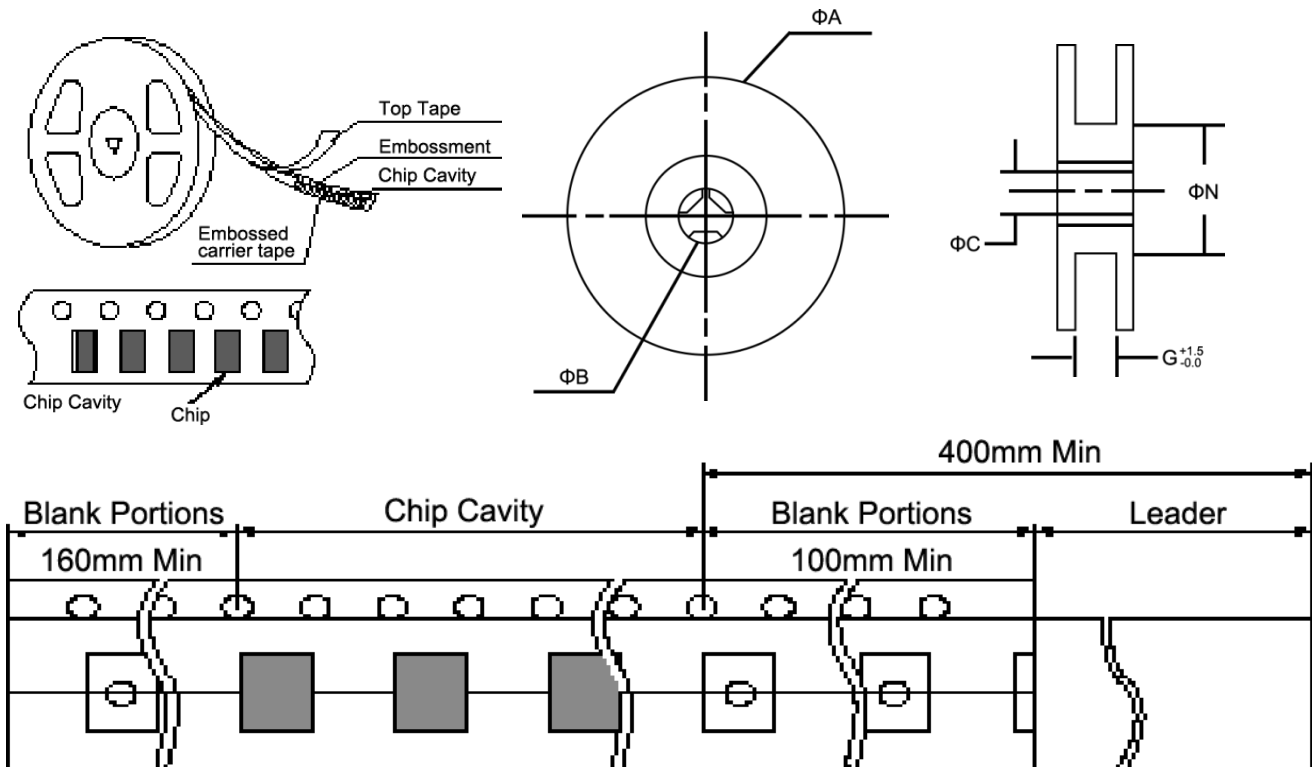
3、电气特性/Electrical characteristics

型号	Z(Ω)	DCR(Ω)Max	Idc(mA)Max	额定电压(V)
TSCW3225-800N	80	0.12	640	50
TSCW3225-161N	160	0.15	480	50
TSCW3225-271N	270	0.25	450	50
TSCW3225-501N	500	0.3	1000	50
TSCW3225-601N	600	0.12	1000	50
TSCW3225-801N	800	0.35	350	50
TSCW3225-102N	1000	0.35	350	50
TSCW3225-142N	1400	0.2	1200	50
TSCW3225-242N	2400	0.3	640	50
TSCW3225-800N	80	0.12	640	50

注释

- ◆ K 表示电感值的公差为±10%，M 表示电感值的公差为±20%
- ◆ K said inductance tolerance is ±10%, M said inductance tolerance is ± 20%
- ◆ 所有数据基于环境温度 25℃条件下测试
- ◆ All data is based on testing at an ambient temperature of 25 °C
- ◆ 测试条件：100KHz/1.0V
- ◆ 本页面未能录入全部或最新的数据，请您在订购前向本公司咨询精准参数及样品。
- ◆ We were unable to input all or the latest data on this page. Please consult our company for accurate parameters and samples before placing an order.

4 包装规格/ Packaging specifications 单位/mm



型号	数量 (Pcs/Reel)	A(Ref.)	B(Ref.)	C(Ref.)	N(Ref.)	G(Ref.)
TSCW2012	2000	178±2.0	22±2.0	12.5±1.5	98±2.0	12
TSCW3216	2000	178±2.0	22±2.0	12.5±1.5	98±2.0	12
TSCW3225	1000	178±2.0	22±2.0	12.5±1.5	57±2.0	12
TSCW3225L	1000	178±2.0	22±2.0	12.5±1.5	57±2.0	12
TSCW4532	500	178±2.0	22±2.0	12.5±1.5	57±2.0	12
TSCW4532L	500	178±2.0	22±2.0	12.5±1.5	57±2.0	12

5、焊接/welding

• 焊接原材料 Soldering Materials

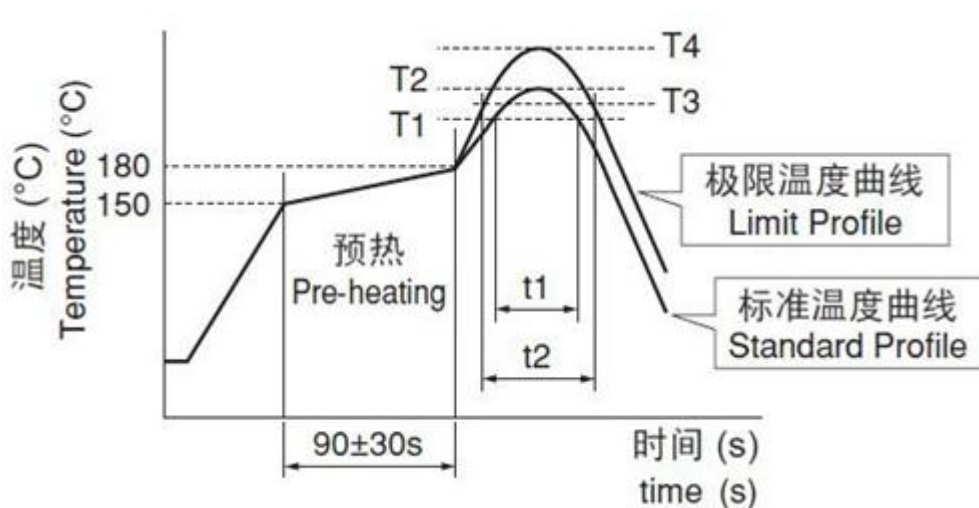
(a) 焊料 : 推荐使用 96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu 焊料 , 或者采用 Sn 含量不超过 97% 的锡合金焊料。 Solder: It is recommended to use 96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu solder, or use Tin alloy solder with a Tin content not exceeding 97%.

(b) 助焊剂 : 推荐使用松香类助焊剂, 请勿使用强酸性助焊剂 (含氯量超过 0.2wt %), 并且请勿使用水溶性助焊剂。

Flux: It is recommended to use rosin-based flux. Acidic flux (with chlorine content exceeding 0.2wt %) and water-soluble flux are forbidden.

• 焊接温度及要求 Soldering Temperature & Requirements

回流焊温度曲线 Reflow Soldering Temperature Profile



回流焊要求 Reflow Soldering Requirements

标准温度曲线 Standard Profile				极限温度曲线 Limit Profile			
加热 Heating		峰值温度 Peak Temp. (T2)	回流焊 次 Cycle Of Reflow	加热 Heating		峰值温度 Peak Temp. (T4)	回流焊次数 Cycle Of Reflow
加热 Temp. (T1)	时间 Time (t1)			温度 Temp. (T3)	时间 Time (t2)		
220°C	30~60s	245±3°C	≤2	230°C	≤60s	260°C/10s	1

6、其他

- ◆ 本产品为无铅, 请采用无铅环境作业
- ◆ Other: Our company's products are lead-free, please operate in a lead-free environment
- ◆ 由于页面限制, 更多资料请联系我司
- ◆ Due to page limitations, please contact our company for more information
- ◆ 在过载电流等不正常条件下, 本电感产品无自我保护功能。
- ◆ Under abnormal conditions such as overload current, this inductor product has no self-protection function.